

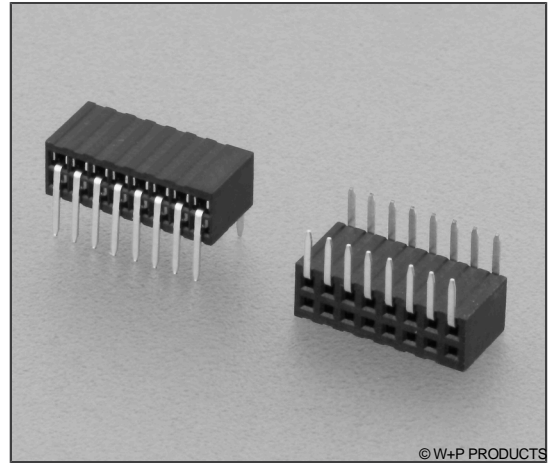
46-713 Economy Version

Buchsenleisten RM 1,27mm, seitlich steckbar, 2-reihig

Female Headers, 1.27mm Pitch, Side Entry, Double Row

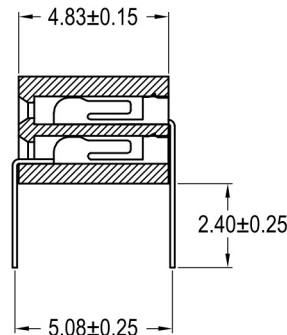
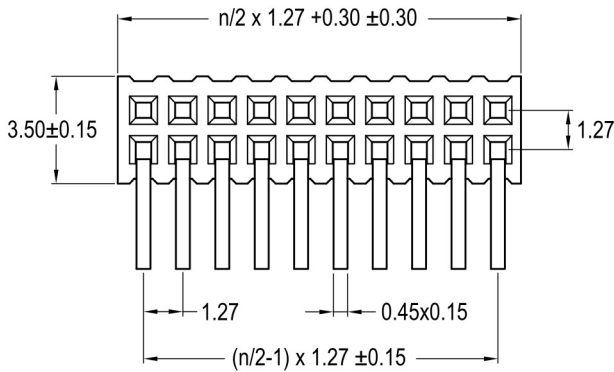
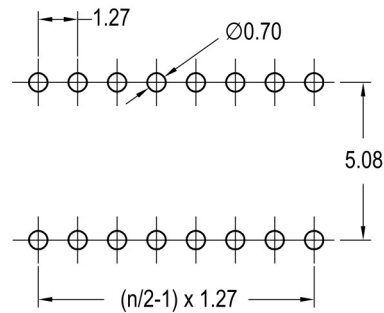
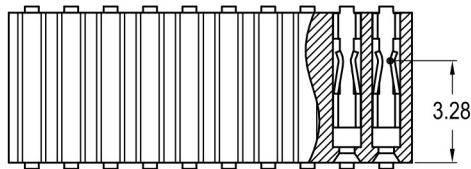
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Au über Ni
<i>Contact Surface</i>	<i>Au over Ni</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC/DC
<i>Test Voltage</i>	<i>500 V AC/DC</i>
Nennstrom	1 A
<i>Current Rating</i>	<i>1 A</i>
Temperaturbereich	-40 °C ~ +105 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40 °C ~ +105 °C</i>
Verarbeitung	260 °C für 10 sec. / 230 °C für 30-60 sec.
<i>Processing</i>	<i>260 °C for 10 sec. / 230 °C for 30-60 sec.</i>



© W+P PRODUCTS

Geeignet für 0,40mm Vierkantstifte
Mates with 0.40mm square pins



Series

46-713

Contacts*

020

006-080 Zweireihig
Double row

Plating

00

00 Vergoldet
Gold plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	Lower Temperature [°C]
Duration above T_L	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

